

平成 14 年 6 月期

中間決算短信 (連結)

平成14年 2月25日

上場会社名 株式会社フォトニクス

上場取引所 大阪証券取引所ナスダックジャパン市場

コード番号 7708

本社所在都道府県 東京都

問合せ先 責任者役職名 取締役 C00

氏 名 柳田 一千一

TEL (03)5941 - 0571

決算取締役会開催日 平成14年 2月25日

米国会計基準採用の有無 無

1 13年12月中間期の連結業績 (平成13年 7月 1日 ~平成13年12月31日)

(1) 連結経営成績 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年12月中間期	619	()	96	()	103	()
12年12月中間期		()		()		()
13年 6月期						

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
13年12月中間期	104	()	11,296	40		
12年12月中間期		()				
13年 6月期						

(注) 持分法投資損益 13年12月中間期 百万円 12年12月中間期 百万円 13年 6月期 百万円
 期中平均株式数 13年12月中間期9,264株 12年12月中間期 株 13年 6月期 株
 平成13年10月15日付で1株を2株に分割しておりますが、1株当たり中間純利益及び期中平均株式数は期首に分割が行われたものとして計算しております。

会計処理の方法の変更 無

(2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
13年12月中間期	2,973	1,552	52.2	167,634 14
12年12月中間期				
13年 6月期				

(注)期末発行済株式数 13年12月中間期9,264株 12年12月中間期 株 13年 6月期 株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
13年12月中間期	232	686	827	774
12年12月中間期				
13年 6月期				

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数1社 持分法適用非連結子会社数 社 持分法適用関連会社数 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結 (新規)1社 (除外) 社 持分法 (新規) 社 (除外) 社

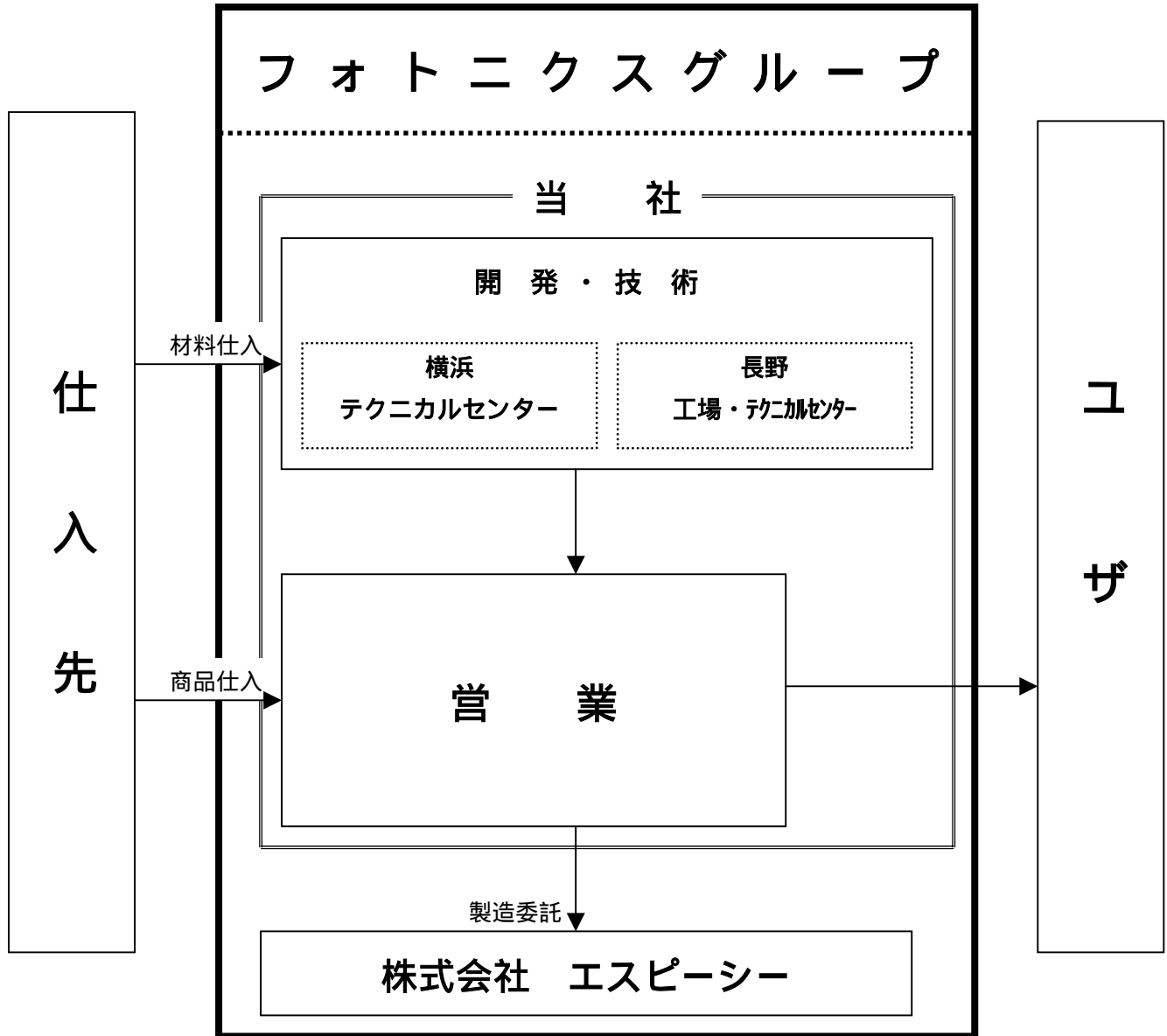
2 14年 6月期の連結業績予想 (平成13年 7月 1日 ~平成14年 6月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	1,550	220	135

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 14,572円 54銭

1. 企業集団の状況

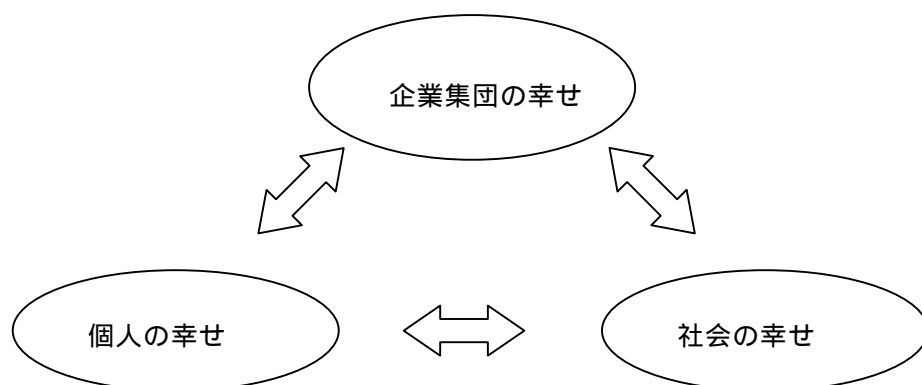
当社の平成13年12月31日現在における企業集団は、当社及び株式会社エスピーシーで構成されております。



2. 経営方針

1. 経営の基本方針

当企業集団は、ステークホルダーとの共生・調和を図りながら、



を追求する近未来技術のハイテクメーカーを目指すベンチャー企業集団であり続けます。

企業集団の幸せ：

ワールドワイドに活躍するエクセレントカンパニーグループとしての企業集団であること

時代の変革を先取りしたオンリーワン企業集団であること

オープンな経営、開かれた組織としての企業集団であること

個人の幸せ：

個人の自己実現する場としての企業集団であること

ユーザーの問題解決チームとしての企業集団であること

高収益、高分配型の経営と同時に社会貢献が出来る企業集団であること

社会の幸せ：

社会のニーズに対応した経済活動を行う良き企業市民としての企業集団であること

常に技術革新を続けるハイテクメーカーとしてのベンチャー企業集団であること

生産現場の安全・環境を確保することを大切にする企業集団であること

2. 利益配分に関する基本方針

当企業集団は、株主に対する利益還元策を経営戦略上の重要課題として認識しております。現状におきましては、経営体質の強化、競争力の維持、事業の拡充、人材の育成を図るための投資の原資として、安定的な資金を確保する必要があると考えております。このため、経営体質の強化等に必要な資金の内部留保を勘案しつつ、安定的かつ継続的な利益還元を行うことを基本として、積極的な株式分割を行うことにより株式の流動性を高めるとともに、これを実質的な増配とすることにより株主への利益還元に取り組んでいく方針であります。

内部留保資金の用途につきましては、経営体質を強化し、将来の事業展開に備えることにより、株主資本利益率の向上を図ってまいり所存であります。

3. 中長期的な経営戦略

当企業集団は、近未来市場における革新的な製品の登場と、それを促進する技術革新、規制の緩和、インフラならびにサービスの充実が新市場を創出し、経済の活性化へつながるものと考えております。これに対処するため、先端分野を研究する大学との産学協同やグローバルなストラテジックアライアンスを積極的に展開し、将来、市場が拡大する見込みである各事業分野に対しては、常にキャッチアップを行っております。

(超精密センサ事業)

超精密センサは、主力製品 PS センサの応用展開をベースにピエゾ・ナノアクチュエーター等のシステム化した商品群を充実し、バイオテクノロジー、光通信、液晶、ディスクの分野をより深掘することにより、多分野への展開をしております。

計測機器は、有機 EL ディスプレイ市場の開拓、ITS(高度道路情報システム)の普及による自動車用ディスプレイ市場、液晶、有機 EL ディスプレイの応用製品市場向けの商品開発を積極的に進め、ラインアップの深掘をしております。

(光計測装置事業)

光計測装置は、市場要求の高度化が急速な光通信分野での光計測、評価検査装置等、近未来の高度光通信分野への応用展開、製品開発などを進め、積極的な製品投入を含めた市場参入をしております。

このため、横浜事業所に最新鋭の MTF 測定装置を導入し、MTF 測定ラボとして測定の受託業務を開始し、新製品の MTF 測定装置のマーケティング拠点としております。

(電子機器その他事業)

超精密塑性加工は、当中間期(平成 13 年 7 月 1 日～平成 13 年 12 月 31 日)において、長岡工場に投資を行い、超精密加工事業を本格稼働しております。

長岡工場は、日本を支える次世代技術かつお家芸である超精密セラミックス加工ならびに超精密金型、スタンピング加工技術をコア技術として、企業成長の根幹となる生産工場としてまいります。

また、長岡科学技術大学の安全工学寄付講座開講に伴い、従来からの安全規格部品の販売に加え、新たな自社製品群として超精密加工部品の事業を本格展開いたします。

4. 会社の経営管理組織の整備等(コーポレートガバナンス)に関する施策

(取組状況)

当企業集団は、企業集団としては未だ小規模ではありますが、設立後まもない時期から、企業が行う意思決定のチェックシステムとして、社外取締役や社外監査役制度を導入しており、現在は、アカウントビリティ、コンプライアンスの遵守とディスクロージャーを重視して弁護士・公認会計士・税理士を社外取締役・社外監査役としております。

(考え方)

当企業集団は、コーポレートガバナンスを企業の意思決定システムへの株主の参加と考えております。すなわち、当企業集団が企業活動を効率よく運営するために企業として、どのような意思決定システムを構築し、その意思決定をいかにチェックするか、また、ステークホルダー間の権限と責任を分担し、いかに付加価値の分配を図るかについてのステークホルダー間のバランスを考えるうえで、株主を重視した経営とするため、株主による企業経営へのモニタリングとコントロールが重要と考えております。

また、各取締役によるアカウントビリティ、コンプライアンス、ディスクロージャー制度等を含め、取締役の責務について理解を深めることを重要課題としております。

5. 会社が対処すべき課題

当企業集団が今後対処すべき課題は、グローバル化した経済環境下において、技術開発型企業集団として事業戦略と事業領域を特定分野に限定することなく、複数分野を対象として事業展開を図ることと認識しております。そのためには、将来、市場が開けて行くであろう分野を複数想定し、そのロードマップ上における製品のコアとなる要素の技術、部品、素材、加工、生産技術に焦点を当て、現段階ではニッチな市場・分野であっても、将来の有望市場と判断すれば果敢に挑戦し、市場が顕在化した時点では常にトップランナーとしての位置付けを確保する戦略を展開し

てまいります。

当企業グループのコアコンピタンス（中核的事業力）を、光・ナノテクノロジー分野における測定、検査、部材、加工の要素技術を展開することに置き、そのロードマップ上で事業展開するように努めてまいります。

特に、ナノレベルの精度で加工した部品、素材を実用化することにより、半導体、情報、自動車、バイオならびに医療分野の技術のブレークスルーを可能とすることに注力してまいります。このことにより、半導体の微細化加工、センサ、ディスプレイ、光通信部品、燃料電池などの分野に幅広い応用用途が開け、ナノテク素材のみならず研究開発機器、製造装置、評価装置などにも取り組むことが新たな市場を開くものと考えております。

3. 経営成績

1. 営業の概況

当中間期におけるわが国経済は回復基調に至らず、ますますデフレ経済の色調を濃くしております。また、平成 13 年 9 月 11 日に起った米国での同時多発テロの影響により、世界経済の先行きはさらに混沌としたものとなっております。この事件は、まさに不確実な時代の象徴となりました。

当企業集団が属する電子業界においては、情報技術産業の世界的な不況の波を受け、産業の米、経済の牽引役である半導体、電子部品業界の落ち込みがわが国経済の低迷をよりいっそう鮮明にする結果となっております。

このような状況がほぼ 1 年続中、わが国の電子業界では生産調整と在庫調整を急速に進めた結果、多少の明るさが見えてきているとも言えます。

前回の IT ブームにおいては、特定の分野に偏った企業業績の伸びが顕著でしたが、今回の緩やかな回復基調においては、幅広い分野での民生機器向け電子部品の回復が特徴となっており、生産活動には活発化の兆しが見えてまいりました。

しかしながら、今後の見通しとしては、デフレの要素と個人消費の低迷はまだ当面続いていくものと思われ、海外市場においては、米国の消費行動に多少の明るさが見えてきてはいるものの、経済全体に長期にわたる力強さが伺えない状況であると見ております。

< 各事業の業績活動状況および当期の見通し >

各事業の業績活動状況

(1) 超精密計測センサ事業

超精密計測センサ事業は、PS センサ、光ファイバーセンサの販売および応用製品の開発販売を軸としたナノテクノロジー分野の計測技術がコアコンピタンスとなっております。特にステッパーを中心とした半導体製造装置業界、超精密位置決めを要する半導体・液晶・高密度大容量ハードディスク・超精密加工機械・検査装置・研究用途などに市場が開けつつある分野です。

このような成長分野においても経済環境の悪化から、半導体分野での開発の延期等の状況が顕著に表れました。当事業の当期販売計画予算においては、この点を十分に考慮をしたつもりではありましたが、その予想をはるかに越えるものがあり、下期予算の修正を余儀なくされました。

しかし次世代の半導体製造装置、300 ミリウェハー対応の機器、液晶のマザーガラスの大型化、高密度大容量ハードディスクに関する加工、組み立て、検査、評価装置などへの新技術対応要求は強く、全体の進み具合に遅れは生じたものの第 2 四半期後半から活発な引き合いがみられるようになり受注に結びつき始めております。

これらの引き合いは特定ユーザーとの共同開発案件が多く、開発完了の時期からみて当期業績への寄与率は低いとみております。

液晶 (LCD) 関連事業は、後工程のモジュールプロセス向け製造装置、検査装置、評価装置の開発販売を軸とした事業であり、アナログ、デジタル信号処理および液晶の特性に合わせた検査パターン信号発生器、メカトロ技術がコアコンピタンスとなっております。

当事業が属する液晶業界は、高い成長率を続けている業界ですが韓国、台湾メーカーとの競合の激しい業界でもあります。日本が得意とする分野でしたが、早い段階からの技術の流出、装置メーカーからの製造技術の流出等により海外メーカーのキャッチアップが短期間に行われたため競合が激しくなり、勝ち組み、負け組みが明確となった業界であります。

当企業集団の顧客は勝ち組み側となっておりますが、その理由としては早くからの海外生産への展開、事業の再構築による重点開発目標への集中等が考えられます。

当企業集団はそのような顧客との取引をより強化し、共同開発チームの一員として有力ベンダーの位置付けを確保

した結果、当期においてもこの分野は着実な成長をしています。

また、次世代対応の検査装置、製造装置等の新製品開発依頼も活発であり、非接触型 OLB 検査装置、画像処理による点欠陥検査装置開発などを共同開発テーマとして進め、製造装置では液晶パネルの軽量化、広視野化を目的としたガラスの研磨技術の確立などを進めております。

これらの開発プロジェクトは当期中にすべて完了し、来期以降の販売計画に反映いたします。当企業集団の独自技術も多く含まれるため開発完了から一定期間を置く事により、現顧客以外への販売も可能であります。

その他、新たな事業展開として有機 EL 分野への進出のための模索を始めております。液晶の次期候補として期待のもたれるディスプレイ技術であり、参入企業が増えている分野です。現在、参入のための要素技術の確立、参入に向けたマーケティングを中心に推進しております。

(2) 光計測装置事業

光計測装置事業は、国際基準に準拠した MTF 測定装置（光学レンズの評価、検査装置）の開発販売、光学技術応用製品の開発販売を軸とした事業であり、光学に基づく検査方法、評価方法の技術がコアコンピタンスとなっています。

販売先には光学系メーカーを中心に高級デジタルカメラ、デジタル方式の高解像度 OA 機器、液晶プロジェクターなどのメーカーがあり、高解像度要求のあるレンズの評価装置が売上の大半を占めます。

当中間期はデジタルカメラの販売が好調であると予想し、拡販を目論見ましたが、経済の先行き不透明感から設備投資の先送りが続出し、不調に終わりました。下期においても設備投資に対する不透明感が見受けられるため販売計画予算を大幅に下方修正いたしました。

しかしながら、中長期的には、成長が期待される分野であり、市場における消費マインドの変化が新たな設備投資の呼び水となるものと考えております。

また、横浜事業所内に MTF の検査評価ラボを平成 13 年 10 月に開設し、潜在顧客の掘り起こしを始めた結果、十分な手ごたえを得ており、顧客の設備投資に対するマインドの転換期を待つ状況となっています。

特殊用途としては、防衛、航空宇宙分野、セキュリティー用近赤外および赤外光学系等の引き合いがあり、積極的な投資の兆しが見えております。また、新しいアプリケーションとして医療用があり人眼測定、人工水晶体（IL0）測定の引き合いが上げられます。

(3) 電子機器その他事業

電子部品事業は、国際安全規格対応品である安全対策機器を中心にドイツから製品を輸入販売しております。

安全対策機器の主要顧客は工作機械、電子部品の実装機械業界で、市場環境が厳しい業界であります。このため、当期における当企業集団の安全対策機器販売の伸びは多くを期待できませんでしたが、近々、国際統一安全規格として ISO 規格が制定され、すべての製品が対象となるため市場が拡大するものと期待しております。またエレベーター業界、大型医療機器業界においては、すでに市場が拡大しつつあります。

超精密塑性加工事業は、携帯電話、小型携帯端末機器等に使用される小型二次電池のケースとなる角型電池ケース、精密小型モーターケース、自動車部品などを超精密塑性加工技術により生産を行っております。

小型二次電池は、Ni-Cd（ニッケルカドミウム）電池、Li-イオン（リチウムイオン）電池、Ni-MH（ニッケル水素）電池を総称し、携帯電話、ノートパソコン、PDA 等のモバイル機器電池として需要が拡大しております。

この事業のコアコンピタンスはシート状の金属材料から深絞り加工により製品を作り出す生産技術、材料の選択と特殊金型技術、プロセスの温度管理を含めた加工油の選択など多岐にわたるノウハウがあげられます。

今後の展開には深絞り技術の一つである D&I（ドロウイング アンド アイオニング）手法を使い、ハイブリッド型自動車用の電池の製造に参入を計画しております。

(4) 安全工学事業

平成 13 年 7 月に長岡技術科学大学へ安全工学の寄附講座として 30 百万円を提供いたしました。国際安全規格は

ISO規格に採択されると、すべての業界における職場での安全対策の統一基準となり、そのための教育プログラムとして安全工学があります。

当企業集団は長岡技術科学大学に安全工学の寄附講座を提供し、安全工学の専門的な教育、普及に努め、東京の荻窪にある東京事業所のビル内にはNPO 安全工学研究所を平成14年3月末予定で設立準備中です。

NPOの活動を通して、より広く産業界への啓蒙普及活動を行い、遠隔教育システムの開発などを行ってまいります。

(5) 研究開発

当企業集団は主たる事業領域である光・ナノテクノロジー分野のセンサ、計測測定技術、光学技術、電子回路およびメカトロニクス技術をコア技術として新たな製品開発のための研究開発を推進しております。

開発テーマは、自社のコア技術を利用し、いかに顧客が抱える問題解決につながるか、その開発の成果物がその業界に広く普及するか、独自性があるか、競合他社との間に差別化要素を取り込めるか等の判断基準をベースとして、市場ニーズに基づいたテーマ選択をしております。市場ニーズが存在し、かつ短期間で成果に結びつくことを重視することにより、開発費用の回収、回転を早めております。

継続中のテーマにはピエゾ・アクチュエーターを駆動源とした超精密位置決めステージ、ドライブ用アンプ、電源の開発、光通信用の計測機器開発などがあり、新たなテーマとして、次世代半導体製造装置対応の表面形状測定装置、膜厚測定装置の開発、液晶ガラス研磨装置および研磨ノウハウの開発、レーザー描画スキャナーユニット、大容量HDDユニット評価装置などを進めております。

上記研究開発テーマの開発完了時期は、第3四半期から第4四半期を見込んでおります。

当期の見通し

当企業集団の製品の主たる販売先は半導体、民生用電子機器、工業用電子機器、生産設備機器等の業界であります。経営方針として特定業種、業界に極度に偏らない分散型営業展開により、業種変動リスクを軽減し、影響の範囲を最小限にとどめる方策をとっておりますが、当中間期の営業状況を分析する限りにおいては、従来の業界区分が大きく変動し、これまでの予測手法やパターンが当てはまらなくなってきました。

顧客別に見ると全般的に前期のような力強い引き合い情報に欠ける点は否めません。また、生産設備機器では投資の活発な分野と投資に極端に消極的な分野がみられ、顧客側の勝ち組み、負け組みが明確になってきております。

特定顧客との共同開発案件等では、経済環境を理由とした遅延による開発の遅れが生じ、第3四半期からの開発開始、第4四半期中完了の案件等が増えた結果、当期への寄与率を期初予想に比べ、大幅に下方修正いたしました。

今後、当企業集団として、業績予想の精度を限りなく高めるため、さらに、営業情報をきめ細かく収集するための仕組みをつくり、収集した営業情報を管理するための仕組みづくり等業務の改善を重ねてまいります。

さらに、四半期ごとの情報開示を徹底し、企業のアカウンタビリティの努力をしまいたる所存であります。

3. 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	当中間連結会計期間末 平成13年12月31日現在	
	金額	構成比
		%
(資産の部)		
流動資産		
1 現金及び預金	2	810,385
2 受取手形及び売掛金	4	299,347
3 たな卸資産		360,565
4 その他		302,413
貸倒引当金		5,298
流動資産合計		1,767,412
		59.4
固定資産		
1 有形固定資産	1,2	
(1) 建物及び構築物		264,224
(2) 土地		466,370
(3) 建設仮勘定		245,646
(4) その他		124,777
		1,101,019
2 無形固定資産		4,911
3 投資その他の資産	2	
(1) その他		108,230
貸倒引当金		7,885
		100,345
固定資産合計		1,206,276
		40.6
資産合計		2,973,688
		100.0

(単位：千円)

科目	当中間連結会計期間末 平成13年12月31日現在	
	金額	構成比
		%
(負債の部)		
流動負債		
1 買掛金	151,213	
2 短期借入金	502,770	
3 賞与引当金	10,687	
4 その他	76,907	
流動負債合計	741,579	24.9
固定負債		
1 長期借入金	673,968	
2 退職給付引当金	5,178	
固定負債合計	679,146	22.9
負債合計	1,420,726	47.8
(資本の部)		
資本金	727,600	24.5
資本準備金	817,100	27.5
連結剰余金	18,522	0.6
その他有価証券評価差額金	10,259	0.4
資本合計	1,552,962	52.2
負債資本合計	2,973,688	100.0

(2) 中間連結損益計算書

(単位：千円)

科目	当中間連結会計期間 自 平成13年 7月 1日 至 平成13年12月31日		%
	金額		
売上高		619,533	100.0
売上原価		390,730	63.1
売上総利益		228,802	36.9
販売費及び一般管理費	1	325,146	52.5
営業損失		96,343	15.6
営業外収益			
1. 受取利息	170		
2. 為替差益	1,495		
3. その他	457	2,123	0.4
営業外費用			
1. 支払利息	5,637		
2. 新株発行費	3,390		
3. その他	368	9,397	1.5
経常損失		103,617	16.7
特別利益			
1. 貸倒引当金戻入益	978	978	0.2
特別損失			
1. 投資有価証券評価損	3,640		
2. 子会社開業準備費用	68,008	71,648	11.6
税金等調整前中間純損失		174,287	28.1
法人税、住民税 及び事業税	2,358		
法人税等調整額	71,996	69,638	11.2
中間純損失		104,649	16.9

(3) 中間連結剰余金計算書

(単位：千円)

科目	当中間連結会計期間 自 平成13年 7月 1日 至 平成13年12月31日	
	金額	
連結剰余金期首残高		132,436
連結剰余金減少高		
1 配当金	9,264	9,264
中間純損失		104,649
連結剰余金中間期末残高		18,522

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科目	当中間連結会計期間 自 平成13年 7月 1日 至 平成13年12月31日
	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
1 税金等調整前中間純損失	174,287
2 減価償却費	18,417
3 退職給付引当金の増加額	179
4 貸倒引当金の減少額	978
5 賞与引当金の増加額	2,612
6 受取利息及び受取配当金	170
7 支払利息	5,637
8 投資有価証券評価損	3,640
9 新株発行費	3,390
10 為替差損益	2,398
11 売上債権の減少額	418,113
12 たな卸資産の増加額	261,895
13 仕入債務の増加額	93,536
14 立替金の増加額	105,000
15 前渡金の増加額	58,818
16 未収・未払消費税等の増減額	46,248
17 その他	18,335
小計	85,935
18 利息及び配当金の受取額	202
19 利息の支払額	6,558
20 法人税等の支払額	139,855
営業活動によるキャッシュ・フロー	232,146
投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 定期預金の純増減	5
2 有形固定資産の取得による支出	682,405
3 投資有価証券の取得による支出	40,000
4 投資有価証券の売却による収入	40,000
5 その他	4,433
投資活動によるキャッシュ・フロー	686,845
財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 短期借入金の純増減	98,200
2 長期借入れによる収入	760,000
3 長期借入金の返済による支出	18,456
4 株式分割に係る新株発行費の支出	3,390
5 配当金の支払額	9,088
財務活動によるキャッシュ・フロー	827,265
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,398
現金及び現金同等物の減少額	89,328
現金及び現金同等物の期首残高	863,978
現金及び現金同等物の中間期末残高	774,650

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	当中間連結会計期間 自 平成13年 7月 1日 至 平成13年12月31日
1 連結の範囲に関する事項	連結子会社の数 1 社 連結子会社の名称 株式会社 エスピーシー
2 持分法の適用に関する事項	非連結子会社及び関連会社がないため、持分法の適用はありません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項	連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。
<p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>(ハ)引当金の計上基準</p> <p>(ニ)重要なリース取引の処理方法</p> <p>(ホ)その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p>	<p>(1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの …中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>(2) たな卸資産 商品、製品及び原材料…総平均法による原価法 仕掛品…個別法による原価法</p> <p>(1) 有形固定資産 定率法 なお、平成10年度の税制改正に伴い、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物及び構築物 10年～27年</p> <p>(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、その利用により将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められる場合にその取得費用を資産計上し、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によって減価償却を実施しております。</p> <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法に基づき、退職金規程に基づく中間連結会計期間末自己都合退職金要支給額より、中小企業退職金共済制度から支給される額を控除した額を計上しております。</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p>
5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

		当中間連結会計期間末 平成13年12月31日現在
1	有形固定資産の減価償却累計額	155,927千円
2	担保資産	
	定期預金	137,776千円
	有価証券	820
	建物及び構築物	243,627
	土地	466,370
	建設仮勘定	16,939
	計	865,533千円
<p>これらは、長期借入金822,538千円*、短期借入金278,200千円及び割引手形70,000千円の担保に供しております。 (*長期借入金673,968千円及び一年以内返済予定の長期借入金148,570千円)</p>		
3	受取手形割引高	70,000千円
4	中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形が中間連結会計期間末残高に含まれております。	
	受取手形	13,637千円

(中間連結損益計算書関係)

		当中間連結会計期間 自 平成13年 7月 1日 至 平成13年12月31日
1	販売費及び一般管理費の主なもの	
	役員報酬	40,240 千円
	給与手当	55,183
	寄付金	33,500
	開発費	54,390
	賞与引当金繰入額	5,349

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

		当中間連結会計期間 自 平成13年 7月 1日 至 平成13年12月31日
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係		
(平成13年12月31日現在)		
	現金及び預金	810,385千円
	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	35,734千円
	現金及び現金同等物	774,650千円

(リース取引関係)

当中間連結会計期間
自 平成13年 7月 1日
至 平成13年12月31日

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
(借主側)

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額

(単位：千円)

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額
その他	308,125	10,671	297,453
合計	308,125	10,671	297,453

経過リース料中間期末残高相当額

1年以内	56,207千円
1年超	242,732千円
合計	298,939千円

支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	12,087千円
減価償却費相当額	10,121千円
支払利息相当額	2,769千円

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

(有価証券関係)

当中間連結会計期間末(平成13年12月31日現在)

有価証券

1 その他有価証券で時価のあるもの

(単位：千円)

	取得原価	中間連結貸借 対照表計上額	差額
株式	820	820	
その他	80,034	62,330	17,704
計	80,854	63,150	17,704

(注)当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について3,640千円減損処理を行っております。なお、当該株式の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合に「著しく下落した」とみなして減損処理を行っております。

2 時価のない主な有価証券の内容

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

当中間連結会計期間(自 平成13年 7月 1日 至 平成13年12月31日)において当グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

(セグメント情報)

1. 事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間(自 平成13年 7月 1日 至 平成13年12月31日)

	超精密計測 センサ事業	光計測装 置事業	電子機器そ の他事業	計	全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売 上高	456,018	56,125	107,389	619,533		619,533
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高						
営業費用	330,244	49,599	137,272	517,117	198,759	715,877
営業利益又は損失	125,773	6,525	29,883	102,416	198,759	96,343

注 1.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2.各区分の主な製品

- (1) 超精密計測センサ事業・・・精密計測機器(PSセンサ)、半導体製造関連機器、液晶検査
・評価装置及び関連機器
- (2) 光計測装置事業・・・・・・・光学計測機器、セラミックス関連機器
- (3) 電子機器その他事業・・・・安全対策機器、超精密塑性加工品

3.営業費用のうち、全社の項目に含めた配賦不能営業費用(198,759千円)の主なものは、開発費、寄付金及び管理部門にかかる費用であります。

2.所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間(自 平成13年 7月 1日 至 平成13年12月31日)において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

3.海外売上高

当中間連結会計期間(自 平成13年 7月 1日 至 平成13年12月31日)において海外売上高がないため、該当事項はありません。

(1株当たり情報)

当中間連結会計期間 (自 平成13年 7月 1日 至 平成13年12月31日)	
1株当たり純資産額	167,634円14銭
1株当たり中間純損失	11,296円40銭

(注)なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、新株引受権を発行しておりますが、1株当たり中間純損失が計上されているため記載しておりません。

平成13年10月15日付で1株を2株に分割しておりますが、当中間連結会計期間の1株当たり中間純損失は期首に分割が行われたものとして計算しております。

(1株当たり指標遡及修正値)

当中間連結会計年度が中間連結財務諸表の初年度であるため、1株当たり指標遡及修正値については記載しておりません。

(後発事象)

該当事項はありません。